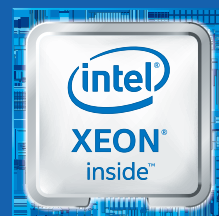


低消費電力で16コアXeon® D-1587搭載。スリム筐体に10GbE×2とPCI-E(x16)×1を装備

HMV-SD15SDV-FM



- インテル® Xeon® プロセッサ D-1587を搭載
- SoCながら、最大16コア (32スレッド)構成
- 最大128GBメモリー (DDR4)搭載可能
- 1基のPCI-E (x16)シグナルを装備
- RJ-45コネクタの10GbEを2基装備
- リモート監視を実現するIPMI2.0装備
- コンパクトなフロアマウントシャーシを採用



■製品特長

システム・オン・チップ (SoC) のインテル® Xeon® プロセッサー D-1587搭載

インテル® Xeon® プロセッサー D-1587は、動作に必要な機能のすべてを一つの半導体チップに実装するシステム・オン・チップ。16コアでTDP65W (1コアあたり約4W)と低消費電力な設計。メモリーはDDR4規格で最大128GBメモリーまで搭載可能です。インテル® Xeon® プロセッサー D-1587は、サーバーやワークステーション用途だけでなく、組み込み向け用途にも対応しているチップセットで長期供給が可能です。

遠隔地からのリモート監視・制御を可能にするIPMIを搭載

ネットワークを通じて、遠隔地からPCの温度・電源・ファンの状態などを監視・制御することができます。

RJ-45コネクタで10GbE高速ネットワーク

10Gbpsのフレーム伝送速度をサポートするRJ-45コネクタタイプの10GbEを2基装備。膨大な量の画像データを高速に伝送することが可能です。

スリムでありながら拡張性に優れたフロアマウントシャーシ

W328mm × D220.9mm × H88.7mmとスリムな設計。装置やシステムに組み込みやすいスリムな筐体にフルハイトサイズの拡張ボードを搭載することが可能です。

■製品仕様

プロセッサー	種類	インテル® Xeon® プロセッサー D-1587(16コア/32スレッド、1.70GHz/ターボ・ブースト時 2.30GHz)
	搭載数	1
チップセット		SoC
メモリー	規格	DDR4 2133/1866/1600MHz
	最大容量	128GB
	スロット数	4
ストレージ	3.5インチベイ	1 (内部1) (空き0) ※標準:ストレージ×1使用
	SATAコネクタ数	6 (SATA 3.0) (空き5) ※標準:ストレージ×1使用
グラフィックス		Aspeed AST2400
I/O	VGA	1
	USB	前面 2 (USB2.0) / 背面 2 (USB3.0)
	LAN	2 (10GbE), 2 (1GbE)
	IPMI	1
拡張スロット	PCI Express x16	1 (x16シグナルGen 3.0)
	M.2	1
外形寸法		W328mm × D220.9mm × H88.7mm (突起物等を除く)
重量		約4kg
電源		日本製電源 170W (連続最大容量) / 220W (ピーク容量)
利用環境	入力電圧	AC90V~240V
	温度	10℃~35℃
	湿度	20%~80% RH (結露なきこと)
保管環境	温度	-10℃~55℃
	湿度	20%~80% RH (結露なきこと)



HPCシステムズ株式会社 CTO事業部
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階
TEL: 03-5446-5535 / hpcs_sales@hpc.co.jp

embe.hpc.co.jp

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viivロゴ、Intel vPro、Intel vProロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。AMD、AMD Radeon、Radeon は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
2018年6月12日現在の内容です。